

2015-2020年中国LED封装市场现状分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国LED封装市场现状分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1412/N51984WYHL.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2014-12-19

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国LED封装市场现状分析及投资前景研究报告》共七章，报告从行业概况、市场格局、设备及原材料、重点企业等多方面多角度阐述了LED封装市场的总体发展状况，并在此基础上对中国LED封装市场的发展前景进行分析和预测。LED封装是指发光芯片的封装，是与市场联系最为紧密的环节。由于封装的技术含量与投资门槛相对较低，因此它是LED产业链中投资规模最大且发展最快的领域。

近年来，传统半导体封装企业开始试水LED封装，半导体封装设备厂商逐步加大LED设备的研发和市场推广，封装企业更多向下游应用领域延伸，且不乏有部分实力企业向上游扩张。

我国LED封装产品经过十多年的发展，已形成门类齐全的各类封装型号，与国外的封装产品型号基本同步。中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，内地LED封装企业的封装产能扩充较快。国内LED封装企业主要分布在珠三角地区，其次是长三角地区。随着更多资本进入大陆封装产业，我国LED封装产能将会进一步扩张。

报告目录

第一章 LED封装相关概述

1.1 LED封装简介

1.1.1 LED封装的概念

1.1.2 LED封装的形式

1.1.3 LED封装的结构类型

1.1.4 LED封装的工艺流程

1.2 LED封装的常见要素

1.2.1 LED引脚成形方法

1.2.2 LED弯脚及切脚

1.2.3 LED清洗

1.2.4 LED过流保护

1.2.5 LED焊接条件

第二章 2013-2014年LED封装产业总体发展分析

- 2.1 2013-2014年世界LED封装业的发展
 - 2.1.1 总体特征
 - 2.1.2 区域分布
 - 2.1.3 企业格局
- 2.2 2013-2014年中国LED封装业的发展
 - 2.2.1 发展现状
 - 2.2.2 产值增长情况
 - 2.2.3 产品结构分析
 - 2.2.4 产业链分析
 - 2.2.5 产能分析
 - 2.2.6 价格分析
- 2.3 2013-2014年国内重要LED封装项目进展
 - 2.3.1 欧司朗在华首个LED封装项目投产
 - 2.3.2 福建安溪引进LED封装线项目
 - 2.3.3 瑞丰光电扩产SMD LED项目
 - 2.3.4 徐州博润LED芯片封装项目开建
 - 2.3.5 晶圆级芯片封装项目落户淮安
 - 2.3.6 厦门信达增资扩建LED封装项目
- 2.4 SMD LED封装
 - 2.4.1 SMD LED封装市场发展简况
 - 2.4.2 SMD LED封装技术壁垒较高
 - 2.4.3 SMD LED封装产能尚未过剩
 - 2.4.4 SMD LED封装受益于芯片价格下降
- 2.5 LED封装业发展中存在的问题
 - 2.5.1 制约我国LED封装业发展的因素
 - 2.5.2 国内LED封装企业面临的挑战
 - 2.5.3 传统封装工艺成为系统成本瓶颈
 - 2.5.4 封装企业选择不当发展模式
- 2.6 促进中国LED封装业发展的策略
 - 2.6.1 做大做强LED封装产业的对策
 - 2.6.2 发展LED封装行业的措施建议
 - 2.6.3 LED封装业发展需加大研发投入

2.6.4 我国LED封装业应向高端转型

第三章 2013-2014年中国LED封装市场格局分析

3.1 2013-2014年LED封装市场发展态势

3.1.1 LED封装市场运行特征

3.1.2 LED封装市场需求结构

3.1.3 LED封装企业规模扩大

3.1.4 LED封装市场发展变局

3.1.5 封装市场上下游战略合作

3.2 2013-2014年LED封装企业布局特征

3.2.1 区域分布格局

3.2.2 珠三角地区分布特点

3.2.3 长三角地区分布特点

3.2.4 其他地区分布特点

3.3 2013-2014年广东省LED封装业分析

3.3.1 产业规模

3.3.2 主要特点

3.3.3 重点市场

3.3.4 发展趋势

3.4 2013-2014年LED封装市场竞争格局

3.4.1 LED封装市场竞争加剧

3.4.2 LED封装市场竞争主体

3.4.3 台湾厂商扩大封装产能

3.4.4 本土企业布局背光封装

3.4.5 封装企业竞争焦点分析

3.5 2013-2014年LED封装企业竞争力简析

3.5.1 2012年LED照明白光封装企业竞争力排名

3.5.2 2013年LED照明白光封装企业竞争力排名

3.5.3 2013年本土LED封装企业竞争力排名

3.5.4 2014年本土COB封装企业竞争力排名

第四章 2013-2014年LED封装行业技术研发进展

- 4.1 中外LED封装技术的差异
 - 4.1.1 封装生产及测试设备差异
 - 4.1.2 LED芯片差异
 - 4.1.3 封装辅助材料差异
 - 4.1.4 封装设计差异
 - 4.1.5 封装工艺差异
 - 4.1.6 LED器件性能差异
- 4.2 2013-2014年中国LED封装技术研发分析
 - 4.2.1 封装技术影响LED光源发光效率
 - 4.2.2 LED封装专利申请状况
 - 4.2.3 LED封装行业技术特点
 - 4.2.4 LED封装技术创新进展
 - 4.2.5 LED封装技术壁垒分析
 - 4.2.6 LED封装业技术研发仍需加强
- 4.3 LED封装关键技术介绍
 - 4.3.1 大功率LED封装的关键技术
 - 4.3.2 显示屏用LED封装的技术要求
 - 4.3.3 固态照明对LED封装的技术要求

第五章 2013-2014年LED封装设备及封装材料的发展

- 5.1 2013-2014年LED封装设备市场分析
 - 5.1.1 LED封装设备需求特点
 - 5.1.2 LED封装设备市场格局
 - 5.1.3 LED封装设备国产化提速
 - 5.1.4 LED前端封装设备竞争加剧
 - 5.1.5 LED后端封装设备市场态势
 - 5.1.6 LED封装设备市场发展方向
 - 5.1.7 LED封装设备市场规模预测
- 5.2 LED封装的主要材料介绍
 - 5.2.1 LED芯片
 - 5.2.2 荧光粉
 - 5.2.3 散热基板

5.2.4 热界面材料

5.3 2013-2014年中国LED封装材料市场分析

5.3.1 LED封装材料市场现状

5.3.2 2014年LED芯片产能分析

5.3.3 2014年LED荧光粉价格走势

5.3.4 LED封装辅料市场面临洗牌

5.3.5 LED封装环氧树脂市场潜力巨大

5.3.6 LED封装用基板材料市场走向分析

5.4 2013-2014年LED封装支架市场分析

5.4.1 LED封装支架市场发展规模

5.4.2 LED封装支架市场竞争格局

5.4.3 LED封装支架市场技术路线

5.4.4 LED封装PCT支架市场前景

5.4.5 LED封装支架技术发展趋势

第六章 2013-2014年国内外重点LED封装企业分析

6.1 国外主要LED封装重点企业

6.1.1 日亚化学 (NICHIA)

6.1.2 欧司朗(OSRAM GmbH)

6.1.3 三星电子 (SAMSUNG ELECTRONICS)

6.1.4 首尔半导体 (SSC)

6.1.5 科锐 (CREE)

6.2 台湾主要LED封装重点企业

6.2.1 亿光电子

6.2.2 隆达电子

6.2.3 光宝集团

6.2.4 东贝光电

6.2.5 宏齐科技

6.2.6 佰鸿股份

6.3 内地主要LED封装重点企业

6.3.1 鸿利光电

6.3.2 瑞丰光电

- 6.3.3 长方照明
- 6.3.4 国星光电
- 6.3.5 木林森
- 6.3.6 杭科光电
- 6.3.7 晶台股份

第七章 博思数据关于中国LED封装产业发展趋势及前景

- 7.1 LED封装产业未来发展趋势
 - 7.1.1 功率型白光LED封装技术趋势
 - 7.1.2 无金线封装成LED封装新走向
 - 7.1.3 LED封装产业未来发展方向
- 7.2 中国LED封装市场前景展望
 - 7.2.1 我国LED封装市场发展前景乐观
 - 7.2.2 LED封装产品应用市场将持续扩张
 - 7.2.3 中国LED通用照明封装市场前景预测

图表目录

- 图表1 LED产品封装结构的类型
- 图表2 2013年全球前十大封装厂商营业收入排名
- 图表3 全球主要LED封装企业的技术特色
- 图表4 第三类企业的发展运作模式
- 图表5 国际大部分著名LED企业遵循的发展模式
- 图表6 2006-2012年我国LED封装行业产值
- 图表7 不同LED封装类型产品图示
- 图表8 2012年我国LED封装市场增长率
- 图表9 台湾、大陆主要SMD LED企业产能对比
- 图表10 2010年在大陆扩产的主要港台企业
- 图表11 国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响
- 图表12 2013年国内LED封装市场重点企业整合动态
- 图表13 广东部分LED封装企业的优势与特色
- 图表14 部分广东省企业和研究机构的封装技术发明专利分布
- 图表15 广东LED器件封装应用领域

- 图表16 2013年台湾重点LED封装厂商营业收入及其增长情况
- 图表17 2012年我国照明用白光LED封装企业竞争力排行榜
- 图表18 2013年我国照明用白光LED封装企业竞争力排行榜
- 图表19 2013年我国LED封装企业竞争力排行榜
- 图表20 2014年我国COB封装企业竞争力排行榜
- 图表21 影响大功率LED封装技术的因素
- 图表22 大功率LED的封装结构
- 图表23 LED封装技术的发展阶段
- 图表24 国内主要LED封装设备企业产品介绍
- 图表25 2013-2014年6月末广州市鸿利光电股份有限公司总资产和净资产
- 图表26 2012-2013年广州市鸿利光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表27 2014年1-6月广州市鸿利光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表28 2012-2013年广州市鸿利光电股份有限公司现金流量
- 图表29 2014年1-6月广州市鸿利光电股份有限公司现金流量
- 图表30 2013年广州市鸿利光电股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
- 图表31 2013-2014年6月末深圳市瑞丰光电子股份有限公司总资产和净资产
- 图表32 2012-2013年深圳市瑞丰光电子股份有限公司营业收入和净利润
- 图表33 2014年1-6月深圳市瑞丰光电子股份有限公司营业收入和净利润
- 图表34 2012-2013年深圳市瑞丰光电子股份有限公司现金流量
- 图表35 2014年1-6月深圳市瑞丰光电子股份有限公司现金流量
- 图表36 2013年深圳市瑞丰光电子股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区
- 图表37 2013-2014年6月末深圳市长方半导体照明股份有限公司总资产和净资产
- 图表38 2012-2013年深圳市长方半导体照明股份有限公司营业收入和净利润
- 图表39 2014年1-6月深圳市长方半导体照明股份有限公司营业收入和净利润
- 图表40 2012-2013年深圳市长方半导体照明股份有限公司现金流量
- 图表41 2014年1-6月深圳市长方半导体照明股份有限公司现金流量
- 图表42 2013年深圳市长方半导体照明股份有限公司主营业务收入分产品、地区情况
- 图表43 2013-2014年6月末佛山市国星光电股份有限公司总资产和净资产
- 图表44 2012-2013年佛山市国星光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表45 2014年1-6月佛山市国星光电股份有限公司营业收入和净利润
- 图表46 2012-2013年佛山市国星光电股份有限公司现金流量
- 图表47 2014年1-6月佛山市国星光电股份有限公司现金流量

图表48 2013年佛山市国星光电股份有限公司主营业务收入分行业、产品、地区

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1412/N51984WYHL.html>